

Z008E0RS
(ON 0NIMVHD)台要図

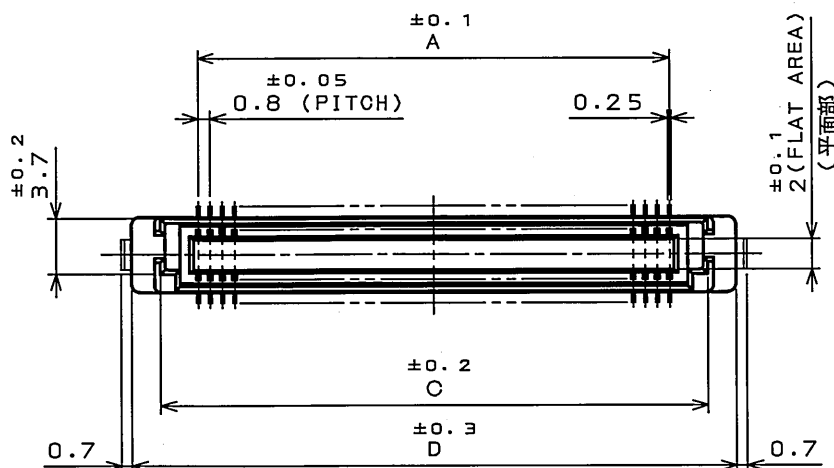


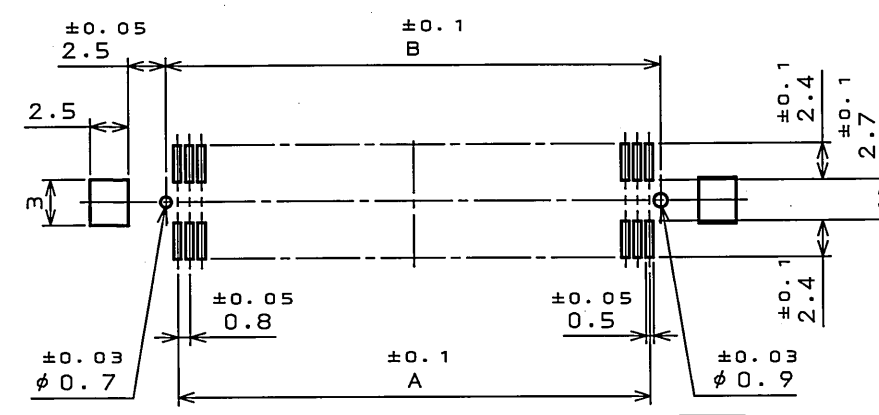
TABLE1 DIMENSION

表1 寸法

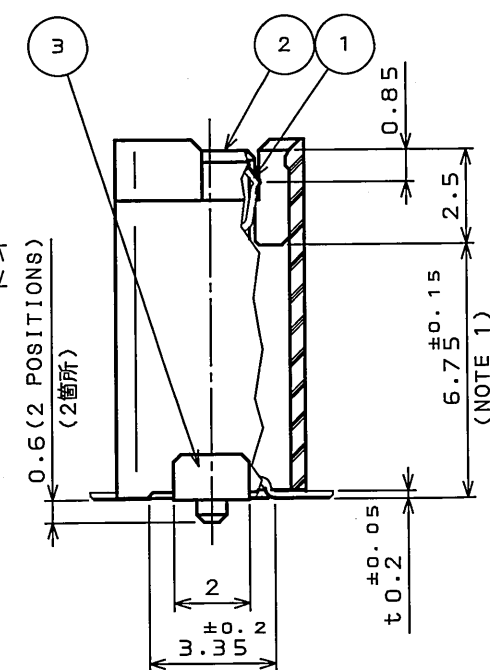
| DEVELOPMENT CONDITION 開発状態 | No. OF CONTACT 芯数 | A | B | C | D |
|-------------------------------|----------------------|------|------|------|----|
| ○ | 20 | 7.2 | 8.7 | 12.3 | 16 |
| ○ | 30 | 11.2 | 12.7 | 16.3 | 20 |
| ○ | 40 | 15.2 | 16.7 | 20.3 | 24 |
| ○ | 50 | 19.2 | 20.7 | 24.3 | 28 |
| ○ | 60 | 23.2 | 24.7 | 28.3 | 32 |
| ○ | 70 | 27.2 | 28.7 | 32.3 | 36 |
| ○ | 80 | 31.2 | 32.7 | 36.3 | 40 |
| ○ | 100 | 39.2 | 40.7 | 44.3 | 48 |
| ○ | 120 | 47.2 | 48.7 | 52.3 | 56 |
| ○ | 140 | 55.2 | 56.7 | 60.3 | 64 |

○: DEVELOPED X: DEVELOPMENT PROGRAM
○: 開発済み X: 開発予定

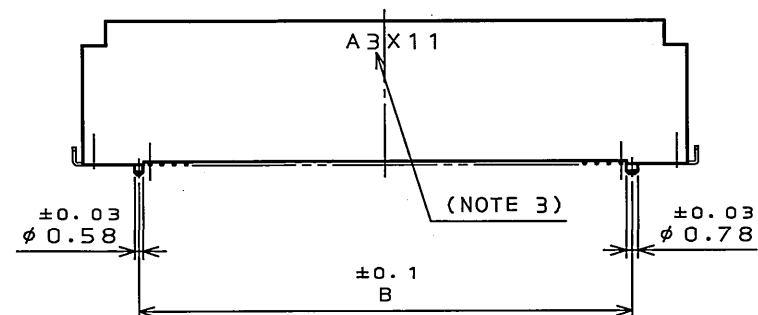
| 版数 REV. | 年月日 DATE | DCN NO. | 変更内容 DESCRIPTION | 製図 DR. | 担当 CHK. | 査閲 APPD. | 承認 APPD. |
|------------|-------------|---------|---------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 2 | 8.00.2003 | 053945 | REVISED TABLE 2 | E.MURANO | H.TAKAHASHI | Y.YAHIRO | S.KASHIWA01 |
| 3 | 7.Jul.2006 | 060584 | ADDED ITEM | | T.URANO | T.Morikawa | Y.YAHIRO |



APPLICABLE P.C.B. DIMENSION (REF.)
適合基板寸法(参考)



(SCALE 5:1)



DESIGNATION

命名法

KX14-***K8D*E

| | | | | | | | |
|-----------------------|---|-------------------------|--|--|--|---|---|
| SERIES PREFIX シリーズ | 14: RECEPTACLE 15: PLUG 14: レセプタクル 15: プラグ | NUMBER OF CONTACT 芯数 | (LEAD FREE)TIN/TIN ALLOY 錫又は錫合金(無鉛) | CONTACT FINISH (TABLE 2) コンタクト仕上(表参照) | MOUNT D: WITH POSITIONING BOSS, WITH HOLDDOWN E: WITH POSITIONING BOSS, WITHOUT HOLDDOWN マウント形状 D: 位置決めボス有・ホルドダウン有 E: 位置決めボス有・ホルドダウン無 | STACKING HEIGHT PER ONE SIDE, KX** (NOTE2) 平行基板間高さ(注2) | N: WITHOUT MISMATING PREVENTION KEY K: WITH MISMATING PREVENTION KEY N: 逆挿入防止キイ無 K: 逆挿入防止キイ有 |
|-----------------------|---|-------------------------|--|--|--|---|---|

TABLE 2 CONTACT FINISH

表2 仕上

| FINISH 仕上記号 | CONTACT AREA 接触部仕上 | TERMINAL AREA 端子部仕上 |
|----------------|--|--|
| △ NONE 無印 | GOLD(0.1μm MIN)OVER NICKEL Ni上Au0.1μm以上 | GOLD FLASH OVER NICKEL Ni上Auフラッシュ |
| 1 | GOLD(0.1μm MIN)OVER NICKEL Ni上Au0.1μm以上 | (LEAD FREE)TIN/TIN ALLOY 錫又は錫合金(無鉛) |
| △ 2 | GOLD(0.3μm MIN)OVER NICKEL Ni上Au0.3μm以上 | GOLD FLASH OVER NICKEL Ni上Auフラッシュ |

NOTE1. COPLANARITY: 0.1mm MAX.
2. STACKING HEIGHT =
HEIGHT OF KX14(RECEPTACLE) + HEIGHT OF KX15(PLUG)
EX.: KX14-***K8, KX15-***K2 → 10mm=8+2
3. PRODUCTION LOT NUMBER IS SHOWN AS INDICATED. (EXCEPT '***K8D9E')
(EX.) A 3 X 1 1
LOT NUMBER OF CURRENT MONTH
MONTH (1 TO 9 FOR JAN. TO SEPT. RESPECTIVELY,
OCT.: 0, NOV.: X, DEC.: Y)
YEAR (LAST DIGIT ONLY)
MANUFACTURER CODE

注1. 端子の平坦度は、0.1以下。
2. KX14(レセプタクル)の数と、KX15(プラグ)の数とを加えた値が
平行基板間高さになります。
3. 図示の面に、ロット番号を表示する。(***K8D9Eを除く)
(例) A 3 X 1 1
月の生産ロット番号
月表示: 1~9(10月: 0, 11月: X, 12月: Y)
年表示(西暦末尾)
製造コード

| | | | | | |
|-------------------------|-------------------|--------------------|------------------|--------------------------|---------------|
| 3 | HOLD DOWN | 2 | COPPER ALLOY | (LEAD FREE)TIN/TIN ALLOY | |
| 2 | INSULATOR | 1 | GLASS FILLED LCP | | COLOR: BLACK |
| 1 | CONTACT | TABLE 1 | COPPER ALLOY | TABLE 2 | |
| 符号 NO. | 名称 DESCRIPTION | 個数 QTY. | 材料 MATERIAL | 仕上 FINISH | 備考 REMARKS |
| 仕様書(SPECIFICATION) | JACS-1401-* | 第1版(ORIGINAL DATE) | 3.Mar.2003 | 尺度(SCALE) | 2:1 |
| 一般公差(GENERAL TOLERANCE) | | 製図 DR. | E.MURANO | 名称(TITLE) | KX14-***K8D*E |
| 寸法(DIMENSION) | 角度(ANGLES) | 担当 CHK. | H.TAKAHASHI | 査閲 APPD. | |
| . ±0.8 | X° ± | 承認 APPD. | K.SATOU | 質量(MASS) | |
| .X ±0.4 | X°X' ± | | | | |
| .XX ±0.1 | | | | | |
| .XXX ± | | | | | |

JAE CONNECTOR DIV. PROPRIETARY.
COPYRIGHT (C) 2003, JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.

DOF-0-212F(05.08)

LEAD FREE この製品は鉛フリー品です

日本航空電子工業株式会社
JAE ELECTRONICS
INDUSTRY, LTD.
図面番号(DRAWING NO.)
SJ038007
版数
(REV.)
3

図面番号 (DRAWING NO.)

DOF-0-212E(03.08)